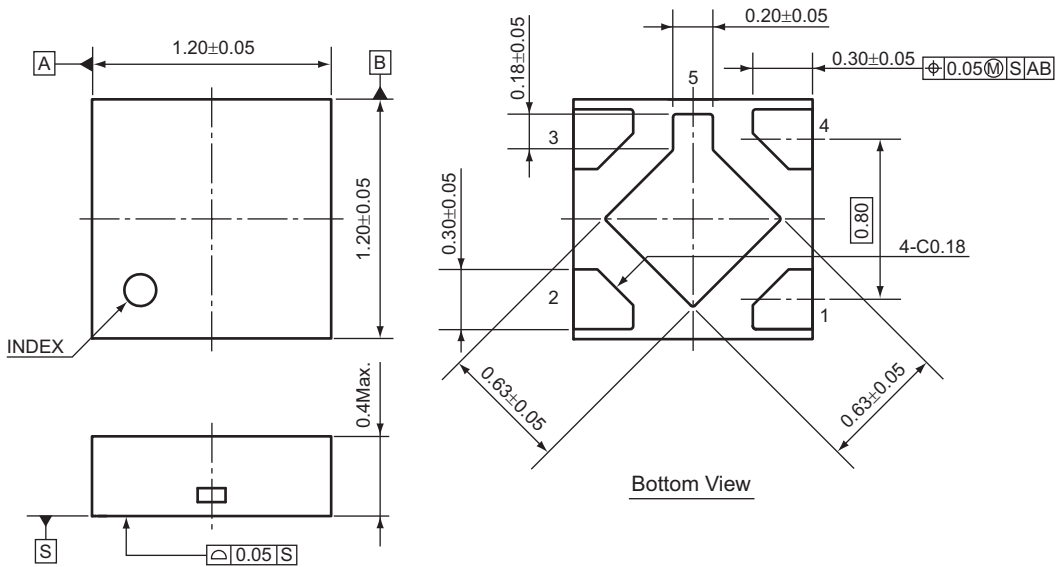


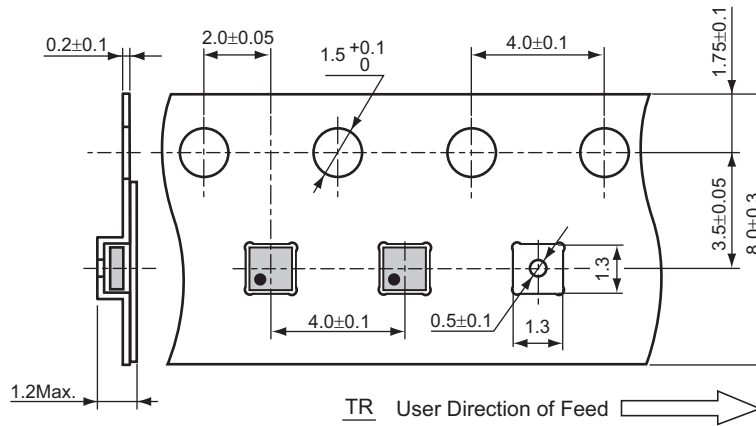
DFN1212-5

(単位 : mm)

■ パッケージ外形図

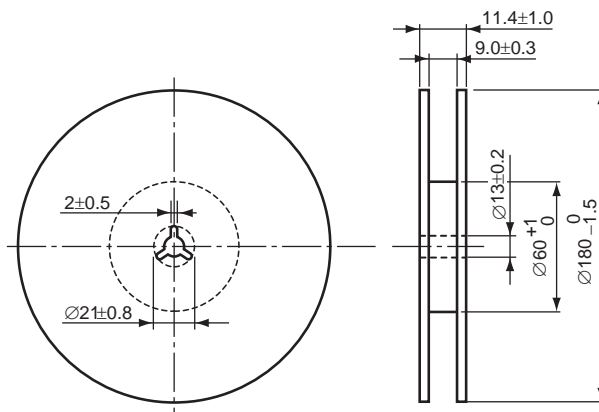


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リユースリール (EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール=5,000 個)



■ 許容損失について (DFN1212-5)

DFN1212-5 パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

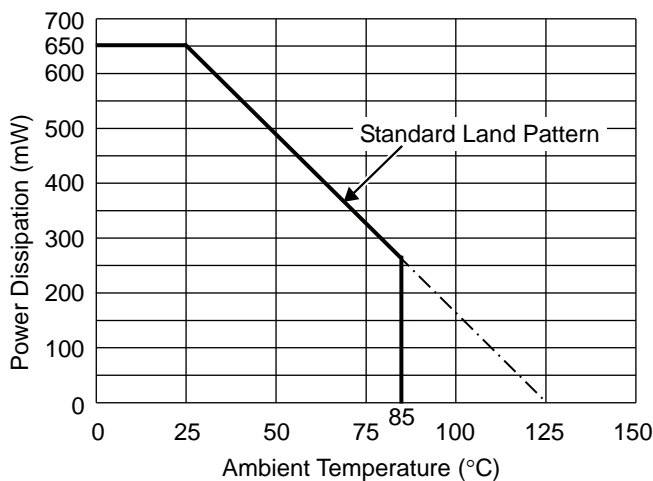
測定条件

	標準実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm
配線率	表面 約50%、裏面 約50%
スルーホール	直径 0.5mm × 28個

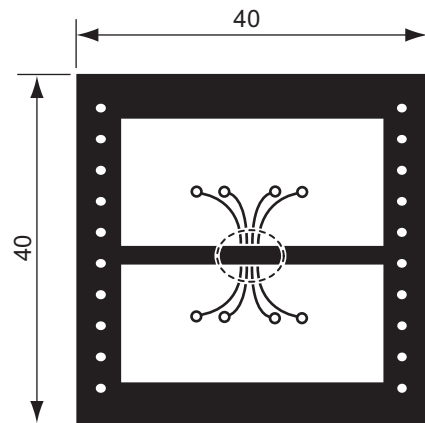
測定結果

(Ta=25°C, Tjmax=125°C)

	標準実装条件
許容損失	650mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/0.65\text{W} = 153^\circ\text{C/W}$
	$\theta_{jc} = 30^\circ\text{C/W}$



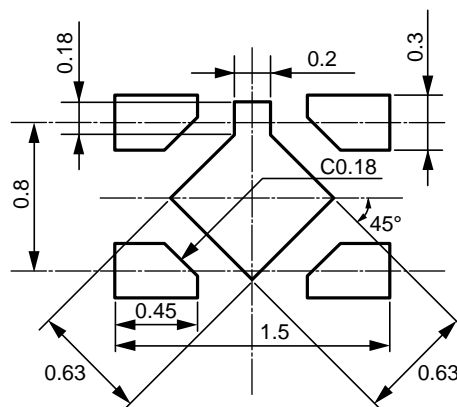
許容損失 対 周囲温度



○ IC 実装位置 (単位 : mm)

測定用基板レイアウト

■ 基板パッド推奨寸法 (DFN1212-5)



(単位 : mm)